

合肥颀中科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-026

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演/反路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参加 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
来访单位名称	博时基金、国元证券、平点金基、上海证券报、财联社、21 世纪经济报道、时代周报、天风证券、统一投信等
时间	2024 年 9 月 11 日-2024 年 9 月 12 日
上市公司接待人员姓名	总经理：杨宗铭 副总经理、董事会秘书、财务总监：余成强 总监：黄昕 证券事务代表：陈颖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 问：合肥厂的定位和产能规划是什么？ 答：合肥厂将以显示驱动芯片封装为主，负责 12 吋晶圆的封装测试，首阶段产能规划为 BP 与 CP 各约 1 万片/月产能，COF 约 3,000 万颗/月产能，COG 约 3,000 万颗/月产能。</p> <p>2. 问：核心技术人员离职对公司的影响？ 答：公司通过长期技术积累和发展，已建立较为完善的研发管理体系，并逐步建立了与行业特征及公司发展需求相适应的人才引进和培养机制，具备良好的人才梯队基础，不存在对特定核心技术人员的单一依赖。截至 2024 年 6 月末，公司研发人员数量为 247 人，较 2023 年末增加 22 人。目前公司的技术研发工作正常运行，核心技术人员的离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。</p> <p>3. 问：公司人才激励计划的政策？ 答：公司于 2024 年 5 月 23 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，确定 2024 年 5 月 23 日为首次授予日，以授予价格 6.25 元/股向符合条件的 253 名激励对象授予 34,950,985 股第二类限制性股票。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在上海证券交易所</p>

	<p>网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-037）等相关文件。</p> <p>4. 问：公司的专利情况如何？</p> <p>答：截至 2024 年 6 月末，公司已取得 117 项授权专利，其中发明专利 55 项（中国 49 项，国际 6 项）、实用新型专利 61 项，外观设计专利 1 项。</p> <p>5. 问：公司和颀邦的关系？</p> <p>答：2004 年成立之初，苏州颀中一方面通过购进先进的封装设备，另一方面在早期来自颀邦科技的少部分高级管理人员及技术人员带领下，通过本土人才的引进和培养，快速实现了金凸块及后段 COF 封装规模化生产能力，并自行建立了相对独立的生产、研发体系。2018 年，合肥颀中科技成立，通过收购苏州颀中并引入战略投资者，进一步充实了自身发展所需的资金和资源。公司充分利用股东投入资本，迅速扩大生产规模，在此阶段，颀邦科技除作为间接股东通过委派董事正常参与公司治理、行使股东表决权外，不存在任何直接或间接参与公司经营管理、技术研发的情况。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动，公司严格按照相关规定沟通交流，不存在未公开重大信息泄露等情形。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 9 月 12 日</p>